

2024年11月8日

会社名 株式会社 ブイ・テクノロジー
代表者 代表取締役 兼 社長執行役員 杉本 重人
(コード番号：7717 プライム市場)
問合せ先 社長室 IR グループ長 吉村 省吾
(TEL：045-338-1980)

生成 AI 用高性能半導体のパッケージ量産に寄与、DI 露光装置「LAMBDI」3号機を受注
～DI 事業の受注高が 20 億円を突破しました。～



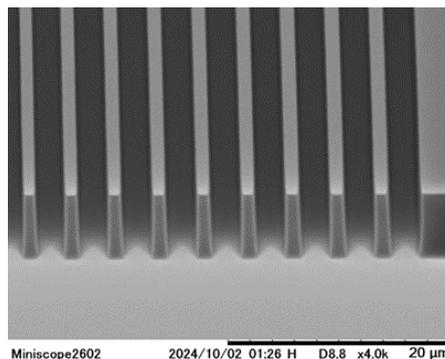
(左)インターポザー・先端パッケージ基板用 DI 露光装置「LAMBDI シリーズ(LE-TECHNOLOGY 社製)」
(右)プリント基板用 DI 露光装置「NEX シリーズ (CFMEE 社製、同社の総代理店として販売・サポート)」

株式会社ブイ・テクノロジー（本社：神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134 横浜ビジネスパーク イーストタワー9F 代表取締役 杉本 重人、以下「当社」）は、HPC 用アドバンスドパッケージ・インターポザー、および汎用プリント基板(車載、産業・通信機器、ロボット、航空宇宙、メディカル等用途、以下汎用 PCB)のお客様に向けて、ダイレクトイメージング露光装置(DI)を2023年よりお届けしてまいりました。

この度、子会社の株式会社 LE-TECHNOLOGY（本社：東京都新宿区市谷八幡町2-1 DS 市ヶ谷ビル5F 代表取締役社長 李 惲、以下「LET」）は、同社独自の高速・高精度露光を実現する DI 技術について、大手パッケージ基板のお客様より高い評価を獲得し3号機を受注いたしました。本装置については、世界初の2um 対応量産装置であり年内の出荷を予定しております。

一方、世界で1500台を超す納入実績を誇る CFMEE 社製 DI の販売・メンテナンスサポート事業については、国内外のお客様から数多くの反響を得て受注台数を伸ばしており、2つ DI 事業の受注高は20億円を突破、事業の拡大が着実に進んでおります。

また、これら事業の更なる拡大に向けて、お客様の多様なニーズに幅広く対応する為の新技术の開発を推進しており、特に、ガラスコア等の次世代パッケージ生産に寄与する L/S=1/1 μ m 対応の DI の開発については年内の開発完了を見込んでおり、2025 年度前半での出荷を計画しております。



LAMBDI 露光サンプル：1.2 μ m レジストパターン

2つのDI事業が展開する半導体パッケージおよび汎用PCBの分野は、社会課題・ビジネス課題の解決を促進するデジタルトランスフォーメーション（DX）やグリーントランスフォーメーション（GX）といった情報技術を根幹で支えるものとして、中長期的な成長が期待される分野です。

当社は、今後も引き続き半導体やディスプレイ等の電子デバイスの多様な進化を支える革新的な技術の開発に注力していくとともに、大きいなる志と溢れる情熱で世界最高のイノベーションを創造し、社会に貢献してまいります。

以上